株主のみなさまへ

株主のみなさまにおかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。

第103期の中間報告書をお届けするにあたりまして、ご挨拶申しあげます。

昨年来のITバブル崩壊に伴う世界経済の減速が続く中、当中間期は、米国を中心とする海外の通信事業会社の破綻や業績不振により、通信市場が予想を超えて悪化し、また、米国の不正会計疑惑などによる市場の混乱などにより米国および国内において急激な株安が進行するなど、景気の先行きに対する不透明感が急速に強くなりました。

このような経済環境のもと、国内においては、公共分野を中心とするソフトウェア・サービスビジネスの売上は堅調に推移したものの、通信事業会社向けインフラ設備、企業向けサーバ等のプラットフォーム製品の売上が低迷し、海外においては、前年同期に比べ、通信事業者向けインフラ設備の売上が大きく減少いたしました。

また、上期前半では半導体の需給バランスの改善が進み、市況回復の兆しが見えましたが、後半に入り、フラッシュメモリの価格下落が進み、半導体の売上は、前年同期に比べ減少いたしました。

この結果、各ビジネス分野で売上が減少し、当中間期の連結売上高は2兆1,503億円（前年同期比9.9％減）となりました。

昨年度の事業構造改革及びコストダウンの推進により、各ビジネス分野で固定費の削減を進めており、ソフトウェア・サービス分野においては、営業利益が増加しましたが、グループ全体では固定費の削減以上に売上の減少が大きく232億円の営業損失（前年同期は591億円の営業損失）となりました。

また、通信市場をはじめとして予想を超えて市場が冷え込んでおり、プラットフォーム、電子デバイスビジネスの開発・製造体制の再構築およびスリム化のため、事業構造改善費用を特別損失に計上し、さらにHDD（小型磁気ディスク装置）の不具合に関する対策費用等を特別損失に計上しました。一方で関連会社であるファナック株式会社の株式を売却し、売却益を特別利益に計上しましたが、当期純損失は1,474億円（前年同期は1,747億円の当期純損失）となりました。

このような状況を鑑み、株主のみなさまへの中間配当金につきましては、誠に遺憾ながら、実施を見送らせていただくことといたしました。株主の皆様のご期待に反しましたことを深くお詫び申し上げます。

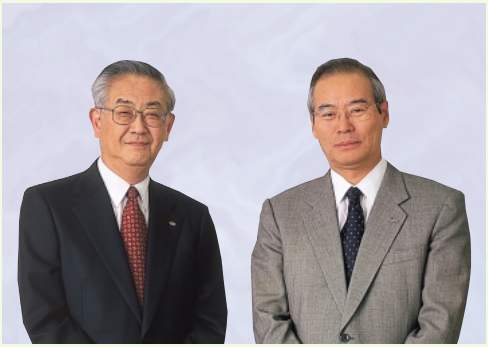
当社グループでは次年度以降の抜本的な業績回復のため、事業構造改革を進めるとともに全事業のソフト・サービス化、通信と情報

のさらなる融合、電子デバイスの市場競争力の強化を進めております。こうした施策を通して、お客様の視点に立ったIT活用の提案を強化し、実現していくことで、お客様のビジネスの拡大に貢献し、同時に富士通グループのビジネスの拡大を図ってまいります。

また、外部から購入する部材が増えていく中で、購入品調達段階での品質評価を強化し、製品品質の一層の向上を図ってまいります。

株主のみなさまにおかれましては、なにとぞ倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

平成14年12月



取締役会長　関澤　義（左側）
代表取締役社長　秋草　直之（右側）

■ビジネス別の概況

当中間期におけるセグメント別の状況は次のとおりです。

ソフトウェア・サービス

国内では官公庁、自治体及び医療分野のIT化への取組みが進んだことにより、各種ソリューションやアウトソーシング等の売上が堅調だったものの、企業のIT投資が減速しており、海外では、欧米の通信事業会社をはじめとした企業のIT投資の抑制の影響を受け売上が減少し、連結売上高は9,180億円（前年同期比1.5％減）にとどまりました。

損益におきましては、EJB部品化技術等による開発の効率化を行い、連結営業利益は515億円（同6.6％増）となりました。

ソフトウェア・サービスビジネスの海外事業は、収益性が低迷しておりますが、顧客のグローバル化への対応、電子政府ビジネス等における海外の先進事例の国内導入において今後も重要性が増すと考えております。昨年度の米国、欧州における事業の再編により一部利益体質化しつつあり、さらなる利益体質への転換を進めております。

国内におけるソフトウェア・サービスビジネスは堅調であり、多様化するお客様のニーズに応えるため、市場で求められているシステムの早期構築と安定運用を実現するGLOVIAソリューションの提供、従来のアウトソーシングから経営コンサルティング、業務改革等上流サービスを拡充したアウトソーシングへの拡大等を推進してまいります。

また、パッケージソリューション、EJB部品化技術の利用によりソフトウェア開発の効率化をさらに推進してまいります。

プラットフォーム

情報処理ビジネスにつきましては、携帯電話の売上が好調であったほか、企業向けUNIXサーバの売上も増加いたしましたが、大規模システムの需要一巡により大型サーバ、ファイルシステムなどの売上が減少したことに加え、昨年度にデスクトップパソコン向け小型磁気ディスク装置ビジネスから撤退した影響により、前年同期に比べ売上が減少いたしました。

通信ビジネスでは、北米を中心とする通信事業会社の設備投資が昨年度以上に縮小し、光伝送システムの売上が大幅に減少したことに加え、国内においてもIMT-2000対応のモバイルシステムの売上が減少し、プラットフォームビジネス全体の連結売上高は7,697億円（前年同期比21.9％減）、308億円の営業損失（前年同期は399億円の営業損失）となりました。

通信ビジネスでは今後の需要が見込まれるブロードバンド・ネットワークインフラ、IMT-2000、IPネットワーク製品に経営資源を集中しておりますが、予想を超える国内外の市場の冷え込みに対応して国内の製造工場を縮小し、製造の効率化を図るとともに、ネットワークの企画、構築から運用、保守までをサービス商品として体系化し、ソリューションビジネスを強化することにより、ビジネスの拡大を図ります。

プラットフォームビジネスグループはネットワーク技術とコンピュータ技術の融合プロダクトの開発を推進するため、本年４月に従来の情報処理と通信を統合し、発足いたしました。これにより、新たなビジネス領域を開拓し、拡大を図ってまいります。

電子デバイス

半導体では、ロジックICはディジタル家電向けの需要が増え、前年同期に比べ売上が増加したものの、フラッシュメモリは価格の下落が続き、売上が減少いたしました。また、光通信インフラ向けの化合物半導体の売上は通信市場の低迷にともない低調に推移いたしました。LCD（液晶ディスプレイパネル）、PDP（プラズマディスプレイパネル）の売上は市場の拡大により前年同期を上回りましたが、電子デバイスビジネス全体の連結売上高は2,890億円（前年同期比2.4％減）、231億円の営業損失（前年同期は355億円の営業損失）となりました。

電子デバイスビジネスでは、最先端半導体技術をコアテクノロジと位置付け、富士通研究所やプラットフォームビジネスグループとの連携を強化しております。

最先端半導体の開発を推進するため、他社とのアライアンスを含め、効率的な開発・生産体制の整備を図るなど経営資源の集中を進めており、自社のサーバ、ネットワーク機器向け最先端半導体及び当社が市場で優位性を持つディジタル家電向け、カーナビゲーション向け半導体を重点分野として製品の競争力を強化し、開発投資の回収を図ってまいります。

また、電子デバイスビジネスにおいてもソフト・サービス化を推進し、システムＬＳＩのデザインサービスなどソリューション提案型ビジネスモデルの構築により事業及び収益力の拡大を図ります。